



西南大学

芯片测试

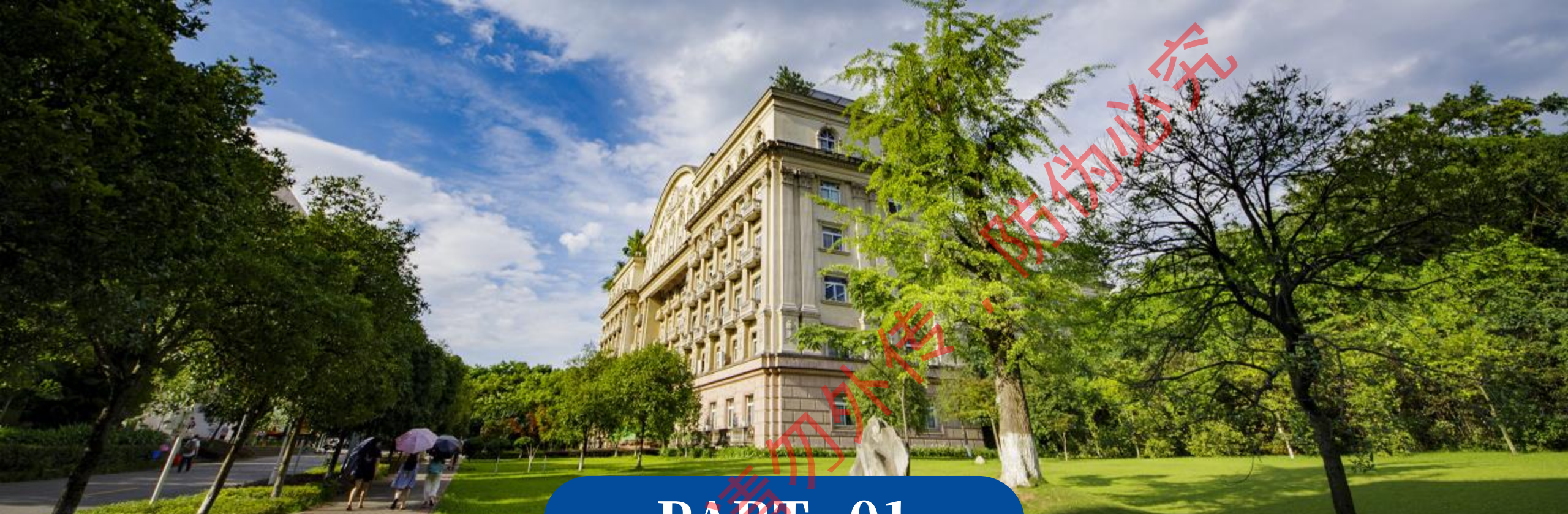
张里博

lbzhang@swu.edu.cn



目录

- 1 芯片测试问题介绍
- 2 芯片测试问题的分治策略
- 3 改进的CW算法
- 4 改进的WZZ算法



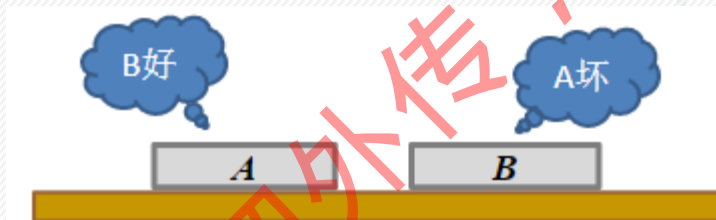
PART 01

问题介绍



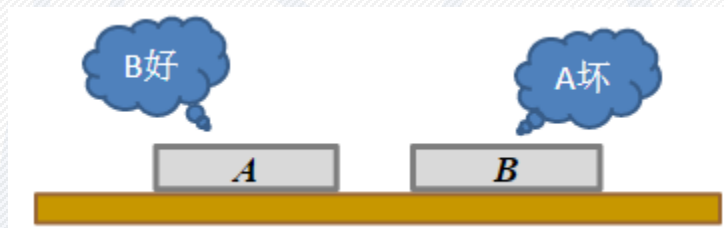
例2.1 芯片测试

- 已知：有 n 片芯片，好芯片至少比坏芯片多1片
- 问题：设计算法，使用尽可能少的测试次数从中挑出1片好芯片。



- 将2片芯片置于测试台上，互相进行测试，测试结果为“好”或者“坏”。好芯片的报告一定是正确的，坏芯片的报告不确定（可能会出错）
- 可以利用的两个条件：
 - 1. 好芯片比坏芯片多； 2. 好芯片的测试报告一定准确；

- **蛮力算法**：任取1片测试，如果是好芯片，**测试结束**；如果是坏芯片，**抛弃**，再从剩下芯片中任取1片测试，直到得到1片好芯片



- **如何判断被测芯片是好芯片呢？**
- 根据**剩余所有芯片轮流、依次**对被选芯片测试，根据**剩余所有芯片**的报告，判断**被测芯片真假**。
- **芯片报告满足什么条件时，被测芯片是好芯片？**



例2.1 芯片测试

算法设计： 如何根据芯片报告的情况判断被测芯片的真实情况？

在具体问题中，已知芯片真实组成情况下，分析报告的情况，据此进行算法规则设计



单次测试结果分析

	A 是好的	A 是坏的
B 是好的	A 、 B 都报告好	A 报告 B 好或者坏， B 报告 A 坏
B 是坏的	A 报告 B 坏， B 报告 A 好或者坏	A 报告 B 好或者坏， B 报告 A 好或者坏



PART 02

芯片测试分治策略

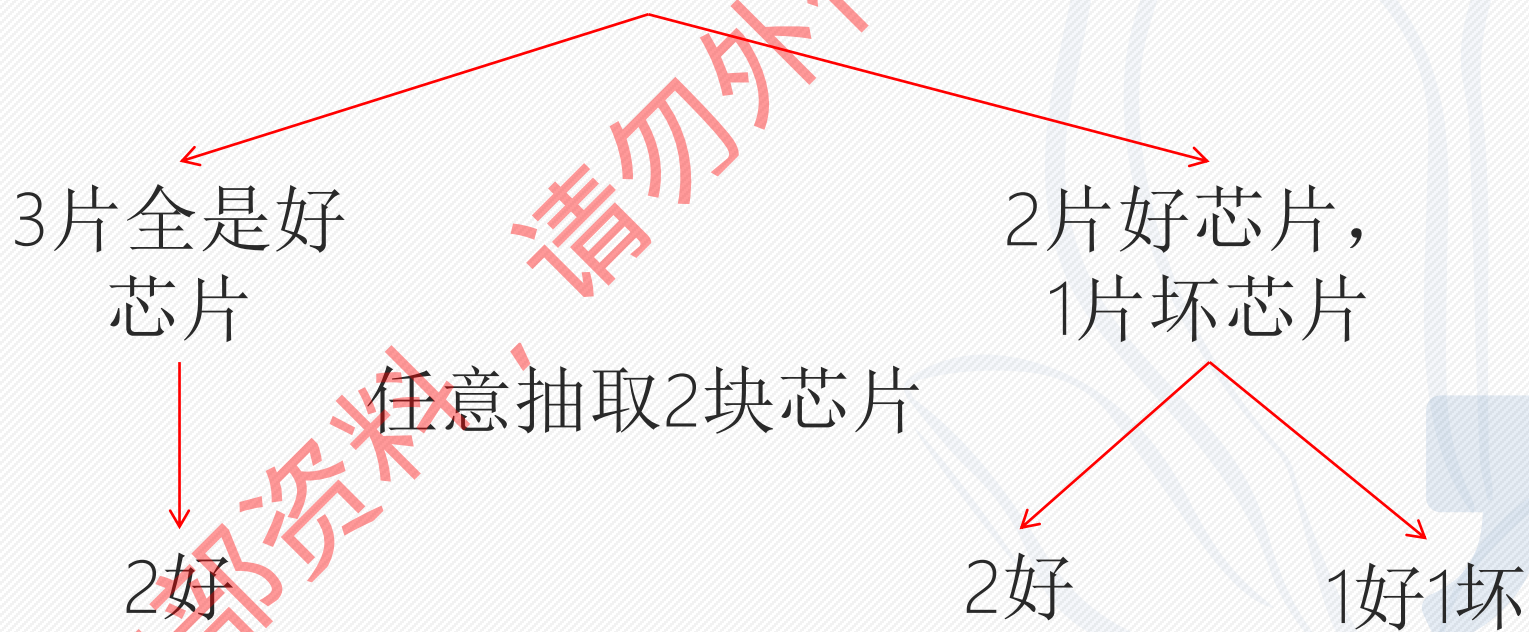


- 要求（需满足的条件）：
 - 1. 子问题与原始问题的性质完全一样；
 - 2. 子问题之间可彼此独立地求解；
 - 3. 递归或迭代停止时最小规模子问题可直接求解。
- 可以利用的两个条件：
 - 1. 好芯片比坏芯片多； 2. 好芯片的测试报告一定准确；
- 最小规模子问题，要如何设计算法？ $n=1, 2, 3$



1. 好芯片比坏芯片多；2. 好芯片的测试报告一定准确

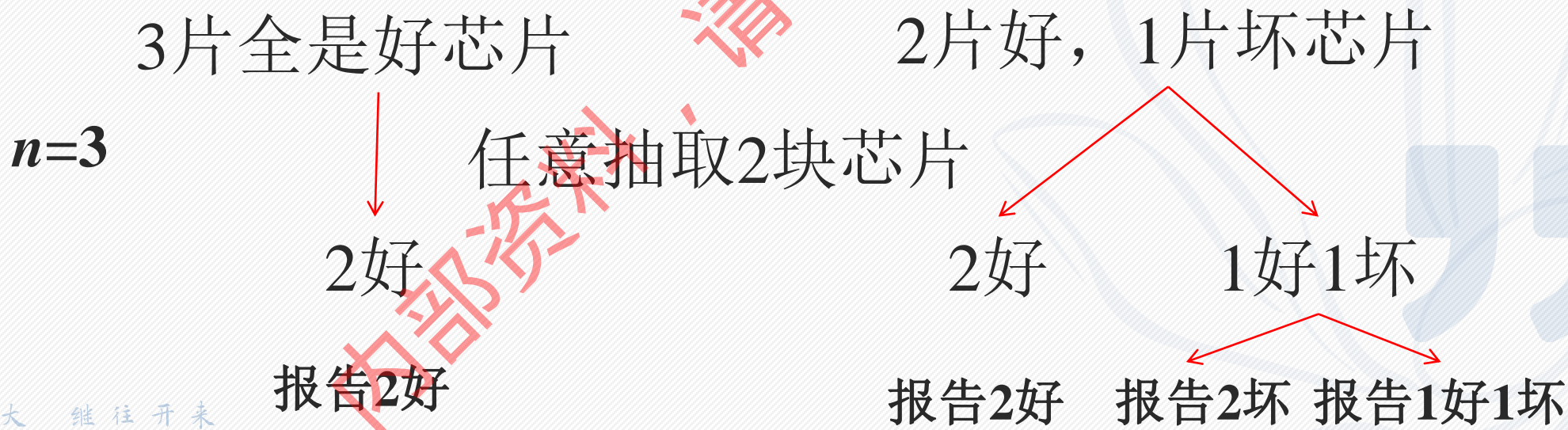
- 从**最小规模问题**分析开始：
- 若只有1片或2片芯片，则全为好芯片；
- 若有3片芯片，如何设计规则，从中挑出1块好芯片？





1. 好芯片比坏芯片多； 2. 好芯片的测试报告一定准确

	A是好的	A是坏的
B是好的	A、B都报告好	A报告B好或者坏， B报告A坏
B是坏的	A报告B坏， B报告A好或者坏	A报告B好或者坏， B报告A好或者坏





教材P30

1. *if* $k == 3$ *then*
2. 任取2片芯片测试;
3. *if* 2片都报好 *then*
4. 任取1片被测芯片;
5. *else*
6. 取没被测芯片;
7. *end*
8. *end*
9. *if* $k == 2$ *or* 1 *then*
10. 任取1片;
11. *end*



这个地方对么？

芯片的真假可知么？

```
1. if  $k == 3$  then
2.     任取2片芯片测试;
3.     if 1好1坏 then
4.         取没测的芯片;
5.     else
6.         任取1片被测芯片;
7.     end
8. end
9. if  $k == 2$  or 1 then
10.    任取1片;
11. end
```



1. 好芯片比坏芯片多； 2. 好芯片的测试报告一定准确

■ 最小子问题可以求解： $n \leq 3$

1片或2片芯片，则全为好芯片；

3片芯片，一次测试即可得到好芯片；

$n > 3$ 时如何设计算法？

目标：保持问题性质（好芯片比坏芯片多）的前提下，
问题规模尽可能快速地减小

$n=3$ 时的筛选规则：报告全好，留一片；其他情况，全丢弃；

两两分组，按照这个筛选规则， $n > 3$ 时会出现什么情况？



例2.1 芯片测试

	A是好的	A是坏的
B是好的	A、B都报告好	A报告B好或者坏， B报告A坏
B是坏的	A报告B坏， B报告A好或者坏	A报告B好或者坏， B报告A好或者坏

A 报告	B 报告	结论
B是好的	A是好的	A,B 都好或 A,B 都坏
B是好的	A是坏的	至少一片是坏的
B是坏的	A是好的	至少一片是坏的
B是坏的	A是坏的	至少一片是坏的

情况一，丢一片留一片；
其他情况，全丢弃；
剩余芯片进入下一轮筛选

子问题与原问题是否性质相同？



淘汰前芯片总数是偶数，子问题是否与原问题性质相同？

命题2.1 当 n 是偶数时，在上述规则下，经过一轮淘汰，剩下的好芯片比坏芯片至少多1片。

证 设 A 与 B 都是好芯片有 i 组， A 与 B 一好一坏有 j 组， A 与 B 都坏有 k 组。

$$2i + 2j + 2k = n;$$

初始好芯片数多于坏芯片 $2i + j > 2k + j; \Rightarrow i > k$

一轮淘汰后好芯片有 i 片，坏芯片至多 k （即 $\leq k$ ）片。

因此，原问题的性质得到保持。



1. 好芯片比坏芯片多；2. 好芯片的测试报告一定准确

淘汰前芯片总数是奇数，子问题是否与原问题性质相同？

输入：好 好 好 坏 坏 坏 好

分组1：好 好 好 坏 坏 坏 好

淘汰后：好 坏 好

分组2：好 好 好 坏 坏 好 坏

淘汰后：好 坏

分组3：好 好 好 好 坏 坏 坏

淘汰后：好 好 坏 坏



1. 好芯片比坏芯片多；2. 好芯片的测试报告一定准确

输入：好 好 好 好 坏 坏 坏
分组：好 好 好 坏 好 坏 坏
淘汰后：好 坏

- 处理办法：当 n 是奇数时，增加一轮对轮空芯片的单独测试（蛮力算法）。
- 如果该芯片为好芯片，则算法结束；如果是坏芯片，删除该芯片，是否能继续分组淘汰？
- 是否是偶数片芯片？是否好 $>$ 坏？



分治策略

```
1.   $k \leftarrow n$ ;  
2.  while  $k > 3$  do  
3.      将芯片分成  $\lfloor k/2 \rfloor$  组; // 如有轮空芯片, 特殊处理  
4.      for  $i \leftarrow 1$  to  $\lfloor k/2 \rfloor$  do  
5.          if 2片都报好 then  
6.              任取1片留下;  
7.          else  
8.              2片同时丢掉;  
9.          end  
10.     end  
11.      $k \leftarrow$  剩下的芯片数;  
12. end  
13. if  $k == 3$  then  
14.     任取2片芯片测试;  
15.     if 2片都报好 then  
16.         任取1片被测芯片;  
17.     else  
18.         取没被测芯片;  
19.     end  
20. end  
21. if  $k == 2$  or  $1$  then  
22.     任取1片;  
23. end
```



分治策略

```
1.  $k \leftarrow n$ ;  
2. while  $k > 3$  do  
3.   将芯片分成  $\lfloor k/2 \rfloor$  组; // 如有轮空芯片, 特殊处理  
4.   for  $i \leftarrow 1$  to  $\lfloor k/2 \rfloor$  do  
5.     if 2片好 then  
6.       任取1片留下;  
7.     else  
8.       2片同时丢掉;  
9.     end  
10.  end  
11.   $k \leftarrow$  剩下的芯片数;  
12. end  
13. if  $k == 3$  then  
14.   任取2片芯片测试;  
15.   if 1好1坏 then  
16.     取没测的芯片;  
17.   else  
18.     任取1片被测芯片;  
19.   end  
20. end  
21. if  $k == 2$  or  $1$  then  
22.   任取1片;  
23. end
```



分治策略

```
1.  $k \leftarrow n$ ;  
2. while  $k > 3$  do  
3.   if  $k$  是奇数 then  
4.     任取1片芯片作为轮空芯片;  
5.     采用蛮力算法对轮空芯片进行判断  
6.     if 轮空芯片为真 then //采用蛮力算法  
7.       return 轮空芯片  
8.     end  
9.      $k \leftarrow k - 1$ ; 删除轮空芯片;  
10.  end  
11. 将芯片分成  $k/2$  组;  
12. for  $i \leftarrow 1$  to  $k/2$  do  
13.   if 2片都报好 then  
14.     任取1片留下;  
15.   else  
16.     2片同时丢掉;  
17.   end  
18. end  
19.  $k \leftarrow$  剩下的芯片数;  
20. end
```

```
21. if  $k == 3$  then  
22.   任取2片芯片测试;  
23.   if 2片都报好 then  
24.     任取1片被测芯片;  
25.   else  
26.     取没被测芯片;  
27.   end  
28. end  
29. if  $k == 2$  or  $1$  then  
30.   任取1片;  
31. end
```



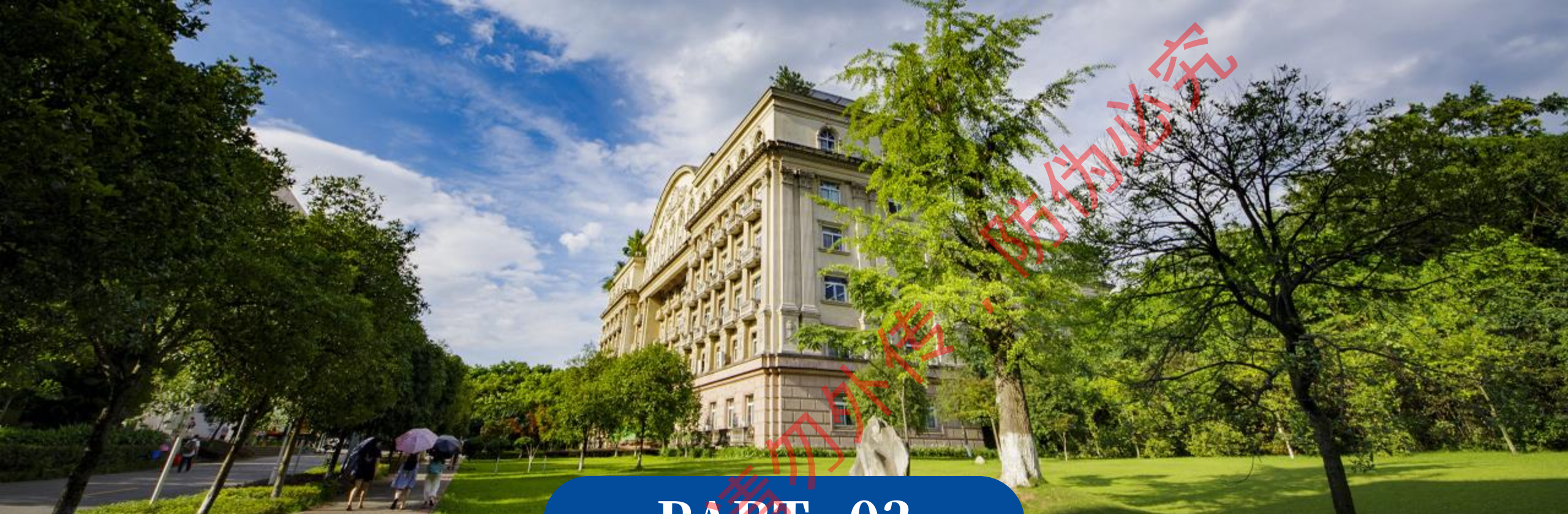

例2.1 芯片测试

■ 递归截至条件: $n \leq 3$

- 3片芯片，一次测试即可得到好芯片；
- 1片或2片芯片，则全为好芯片；

- 时间复杂度的递推式:
 - $W(n) = W(n/2) + O(n-1+(n-1)/2)$ $n > 3$
 - $W(n) = 1$ $n \leq 3$

$$\begin{cases} W(n) = W(\frac{n}{2}) + O(n) & n > 3 \\ W(n) = 1 & n \leq 3 \end{cases} \Rightarrow W(n) = O(n)$$



PART 03

改进的CW算法



- 当芯片总数是奇数，除轮空芯片（剩余偶数片芯片），可以在分组淘汰后，利用蛮力算法对轮空芯片进行测试么？
- 子问题1：当芯片总数是奇数，分组淘汰后，能否根据芯片的报告来判断轮空芯片的好坏么？
- 若轮空芯片为好，return；否则：
- 子问题2：如果轮空芯片为坏，子问题（分组淘汰后的芯片）是否仍与原问题性质相同（好>坏）？
- 如何实现：
- Idea：假设已知芯片真假，得出报告情况；然后，根据报告情况判断芯片真假情况



分组淘汰后，蛮力算法能行不？

(书上29页 命题2.1)

- 轮空芯片真坏——>剩余芯片真好>真坏——>分组淘汰后：
真好>真坏——>报告：好<坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好 \geq 真坏（可分>和=讨论）
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好>真坏——>分组淘汰后：
真好>真坏——>报告：好>坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好=真坏——>分组淘汰后？



命题2.1（增）

命题2.1（增） 当 n 是偶数时，如果好芯片与坏芯片一样多，经过一轮淘汰后，剩下的好芯片不会比坏芯片少。

证 设 A 与 B 都是好芯片有 i 组， A 与 B 一好一坏有 j 组， A 与 B 都坏有 k 组。

$$2i + 2j + 2k = n;$$

$$2i + j = 2k + j; \quad (\text{初始好芯片数等于坏芯片}) \quad \Rightarrow i = k$$

一轮淘汰后好芯片有 i 片，坏芯片至多 k （即 $\leq k$ ）片。因此，剩下的**好芯片个数 \geq 坏芯片个数**。



- 轮空芯片真坏——>剩余芯片真好>真坏——>分组
淘汰后：真好>真坏——>报告：好<坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好>真坏——>分组
淘汰后：真好>真坏——>报告：好>坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好=真坏——>分组
淘汰后：真好 \geq 真坏——>报告：好 \geq 坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好 \geq 真坏——>分组
淘汰后：真好 \geq 真坏——>报告：好 \geq 坏



- 轮空芯片真坏——>剩余芯片真好>真坏——>分组淘汰后：真好>真坏——>报告：好<坏
- 轮空芯片真好——>剩余芯片真好 \geq 真坏——>分组淘汰后：真好 \geq 真坏——>报告：好 \geq 坏
- 两种情况下，报告是互斥的。
- 因此子问题1可以解决：可以根据淘汰后芯片对轮空芯片的报告，判断轮空芯片的好坏；
- 如果轮空芯片为坏芯片，淘汰后的芯片：真好>真坏。
- 因此，子问题2可以解决。即如果轮空芯片为坏，淘汰后芯片仍与原问题性质相同。



- 轮空芯片的情况：真好，或者真坏，
- 分析：两种情况下，**剩余芯片的真实好坏情况**；
两种情况下，**分组淘汰后剩余芯片的真实好坏情况**；
两种情况下，**分组淘汰后测试报告的情况**；
- 两种情况下：
- 1. 分组淘汰后的**测试报告情况是否互斥**，互斥则方案可行，否则不可行；
- 2. 若轮空芯片为坏芯片，测试和删除后，剩下的芯片中**好芯片是否比坏芯片多**。



分治策略

```
1.   $k \leftarrow n$ ;  
2.  while  $k > 3$  do  
3.    if  $k$  是奇数 then  
4.      任取1片芯片作为轮空芯片;  
5.       $k \leftarrow k - 1$ ;  
6.    end  
7.    将芯片分成  $k/2$  组;  
8.    for  $i \leftarrow 1$  to  $k/2$  do  
9.      if 2片都报好 then  
10.       任取1片留下;  
11.     else  
12.       2片同时丢掉;  
13.     end  
14.   end  
15.   $k_s \leftarrow$  剩下的芯片数;  
16.  if 轮空芯片 存在 then // 蛮力算法的一次抽取  
17.    if  $k_s$  个芯片对轮空芯片的报告: 好 < 坏 then  
18.       $k \leftarrow k_s$ , 扔掉轮空芯片;  
19.    else  
20.      return 轮空芯片;  
21.    end  
22.  end  
23. end  
24. if  $k == 3$  then  
25.   任取2片芯片测试;  
26.   if 2片都报好 then  
27.     任取1片被测芯片;  
28.   else  
29.     取没被测芯片;  
30.   end  
31. end  
32. if  $k == 2$  or 1 then  
33.   任取1片;  
34. end
```



例2.1 芯片测试

■ 递归截至条件: $n \leq 3$

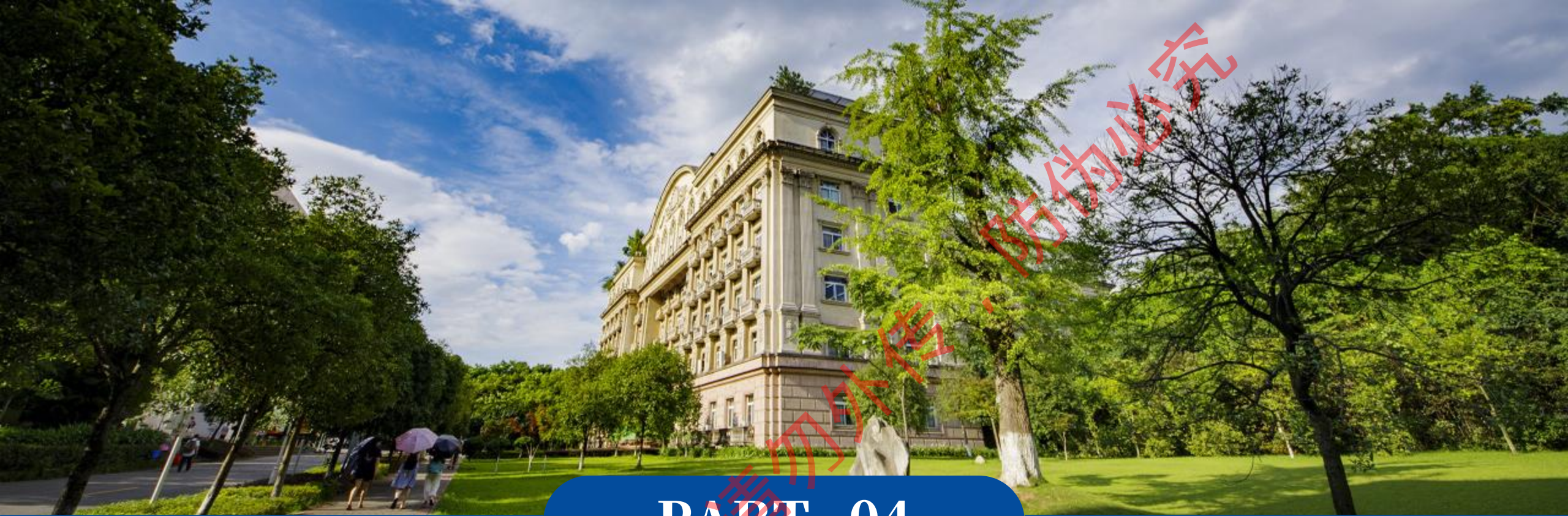
3片芯片，一次测试即可得到好芯片；

1片或2片芯片，则全为好芯片；

- $W(n) = W(n/2) + O((n-1)/2 + (n-1)/2) \quad n > 3$
- $W(n) = 1 \quad n \leq 3$

■ 时间复杂度的递推式:

$$\begin{cases} W(n) = W(\frac{n}{2}) + O(n) & n > 3 \\ W(n) = 1 & n \leq 3 \end{cases} \Rightarrow W(n) = O(n)$$



PART 04

改进的WZZ算法



- 步骤一：当芯片总数为偶数时，扔掉一个（好 > 坏）；
- 步骤二：当芯片总数为奇数时（好 > 坏）：
 1. 任选一个芯片轮空，将剩余的偶数个芯片分组淘汰，淘汰后剩余芯片（不含轮空）个数为 m ；
 2. 若 m 为奇数，扔掉轮空芯片；若 m 为偶数，则保留轮空芯片；保证芯片总数为奇数；
- 步骤三：重复步骤二，直到只剩下一个芯片，该芯片就是好芯片

需要证明的命题：

在经过该算法的一轮操作后，子问题与原问题性质相同
即仍满足好芯片数量大于坏芯片数量



原芯片堆 **好芯片 > 坏芯片**

芯片堆为 **偶数** \rightarrow **好芯片 - 坏芯片 > 2** \rightarrow 扔掉一块芯片, **好芯片 - 坏芯片 > 1** \rightarrow **好芯片 > 坏芯片**

芯片堆为 **奇数** n \rightarrow 轮空一枚芯片, 剩余 **好芯片 \geq 坏芯片** \rightarrow 分组淘汰后有 m 片, **好芯片 \geq 坏芯片**

淘汰后芯片为 **奇数**:

淘汰后 **好芯片至少有 $(m+1)/2$** \rightarrow **好芯片 > 坏芯片** \rightarrow 扔掉轮空芯片 \rightarrow **好芯片 > 坏芯片**

m 为偶数:

命题2.1

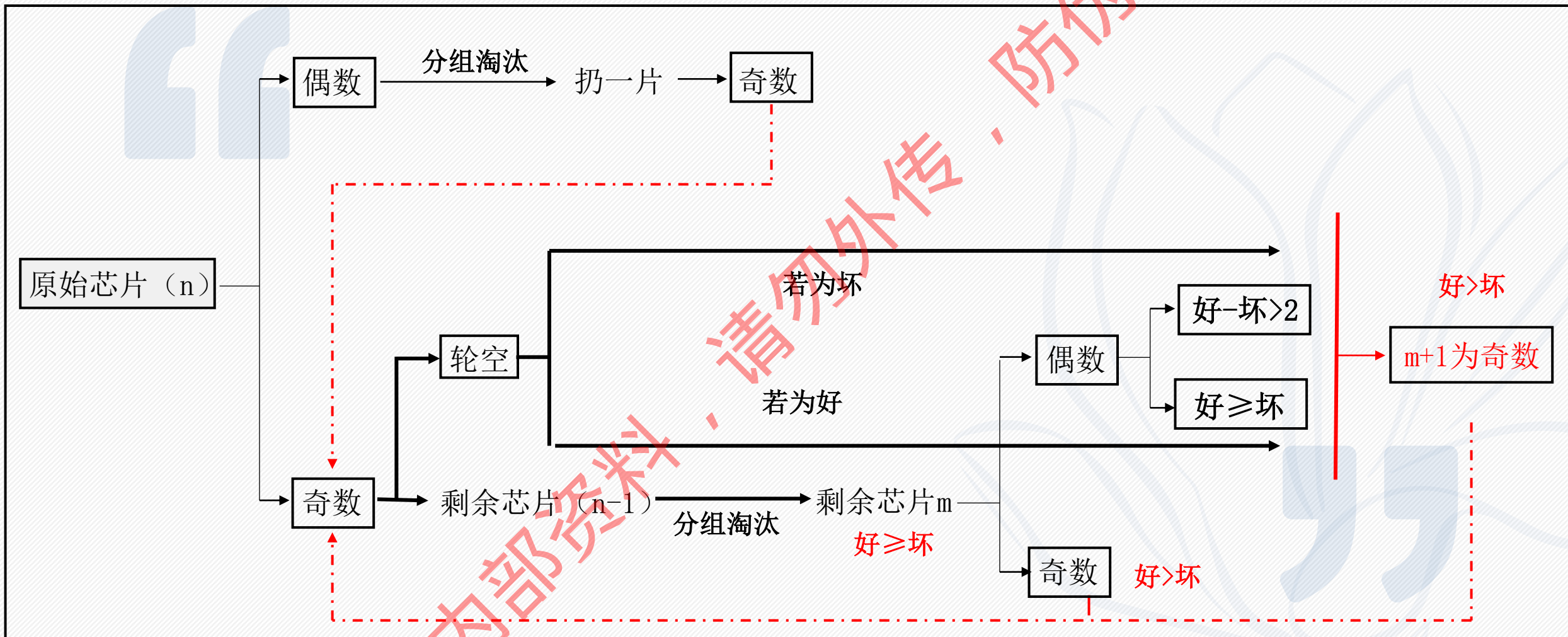
若 **轮空芯片为坏**, 剩余 $n-1$ 块芯片 **好 > 坏** \rightarrow 淘汰后 **好芯片 > 坏芯片 (总数 > 0)** \rightarrow 淘汰后 **好芯片比坏芯片至少多两片** (好芯片至少有 $m/2+1$) \rightarrow 拿回轮空芯片 (坏) \rightarrow **好芯片 > 坏芯片**

命题2.1 (增)

若 **轮空芯片为好**, 剩余 $n-1$ 块芯片 **好 \geq 坏** \rightarrow 淘汰后 **好芯片 \geq 坏芯片 (总数 ≥ 0)** \rightarrow 拿回轮空芯片 (好) \rightarrow **好芯片 > 坏芯片**



推导过程





Test(n)

1. if n为偶数 then
2. 随机丢掉一片;
3. $n \leftarrow n-1$;
4. end
5. $k \leftarrow n$;
6. while $k > 1$ do
7. 轮空一个芯片
8. $k \leftarrow \text{out}(k-1)$;
9. **if** k为偶数 then
10. 拿回轮空芯片
11. $k \leftarrow k+1$;
12. **end**
13. end
14. return 剩下的最后一个芯片

迭代实现

输入: n片芯片构成的数组, 其中好芯片至少比坏芯片多1片

输出: 1片好芯片

out(k) //分组淘汰, k应为偶数

1. 将芯片分成 $k/2$ 组
2. for $i \leftarrow 1$ to $k/2$ do
3. if 2片好 then
4. 任取一片留下
5. else
6. 2片同时丢掉
7. end
8. end
9. $k \leftarrow$ 剩余芯片数;
10. return k;



分组淘汰的时间复杂度为 $O(n/2)$

■ 书上算法时间复杂度递推方程:

$$\blacksquare W(n) = W(n/2) + O(n-1 + (n-1)/2) \quad n > 3$$

$$\blacksquare W(n) = 1 \quad n \leq 3$$

■ CW算法时间复杂度递推方程:

$$\blacksquare W(n) = W(n/2) + O((n-1)/2 + (n-1)/2) \quad n > 3$$

$$\blacksquare W(n) = 1 \quad n \leq 3$$

■ WZZ算法时间复杂度递推方程:

$$\blacksquare W(n) = W((n-1)/2 + 1) + O((n-1)/2) \quad n \geq 1$$

$$\blacksquare W(n) = 1 \quad n = 3$$

算法优势分析: 最坏情况下的时间复杂度均为 $O(n)$

但容易看出, 新算法的实际测试次数比原算法少很多, 效率更高



- 问题：从 n 块芯片（好>坏）中，使用最少测试挑出1片好芯片。
- 工具：好芯片的测试报告一定准确；
- 算法设计思路：在具体问题中，假设已知芯片真实组成情况下，分析报告的情况，据此进行算法规则设计
- 最小规模子问题可如何求解？（ $n=1, 2, 3$ ）
- $n>3$ 时，算法设计目标？淘汰规则？偶数？奇数？时间复杂度？
- CW算法：起点？具体问题？分析过程？算法设计？时间复杂度？
- WZZ算法：起点？分析过程？算法设计？时间复杂度？

